

### Holo/OR Modules DeepCleave

## Découpe de Verre Epais au Laser

LASER COMPONENTS présente le module DeepCleave de Holo/OR, une solution entièrement optique pour la découpe de matériaux transparents, comme les écrans plats pour téléphones portables. Un système de lentilles avec un élément optique diffractif est utilisé pour focaliser un faisceau laser monomode et créer une ligne de focalisation étirée de 2 mm dans la direction du faisceau (axe Z). Cette zone de 1,8 µm de diamètre présente une répartition uniforme de l'intensité.

Intégré dans un tube, le système DeepCleave correspond à un objectif avec une ouverture numérique de 0,35 et peut être utilisé immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des lentilles supplémentaires ou des optiques coûteuses. Avec un DOE de Holo/OR, le module DeepCleave comprend également le système optique sophistiqué nécessaire pour générer la longue ligne focale avec une densité de puissance constante. Pour ce faire, un faisceau d'entrée d'une taille définie avec précision et d'un M<sup>2</sup> de faible valeur sont nécessaires.

Dans la production en série de verre pour téléphones portables, écrans, cellules solaires et autres applications haut de gamme, des coupes longues et précises doivent être effectuées dans des délais très courts. Des vitesses de coupe supérieures à 500 mm par seconde ne sont pas rares, la qualité de coupe ayant une influence décisive sur la flexibilité et la durabilité des composants obtenus. Les lasers avec une ligne uniforme sur l'axe Z peuvent pénétrer profondément dans le matériau et ainsi donner des résultats optimaux.

### Plus d'info

[lasercomponents.com/fr/produit/elements-optiques-diffractifs-destines-a-la-mise-en-forme-de-faisceaux/](http://lasercomponents.com/fr/produit/elements-optiques-diffractifs-destines-a-la-mise-en-forme-de-faisceaux/)

### Trade Shows

ECOC, September 22 – 26, 2019, Dublin, Ireland, **Booth 337**  
 22. **Breitbandkongress des FRK**, September 23 – 24, 2019, H4 Hotel, Leipzig  
**Measurement World**, September 24 – 26, 2019, Paris expo Porte de Versailles, France  
 JNPLI, September 25 – 26, 2019, Strasbourg, France  
**Photonex Europe**, October 09 – 10, 2019, Ricoh Arena, Coventry, UK, **Booth D15**

### La Société

LASER COMPONENTS est spécialisé dans le développement, la fabrication, et la vente de composants et de services dans l'industrie du laser et d'optoélectronique. LASER COMPONENTS est au service de ses clients depuis 1982 avec des bureaux de ventes dans cinq pays différents. Nous produisons nos produits en interne depuis 1986 avec des sites de production en à l'Allemagne, au Canada, et aux Etats-Unis. Notre production interne représente approximativement la moitié de notre chiffre d'affaires. Une entreprise familiale de plus de 230 employés dans le monde.